



速传电子材料有限公司

Speed Spread Electronic Materials Co., Ltd

Introducción a los Productos de Ingeniería

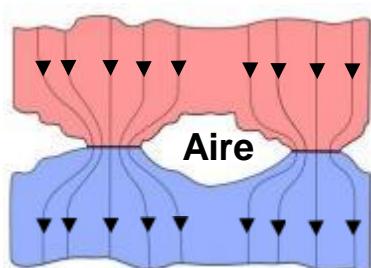


TIM Brief

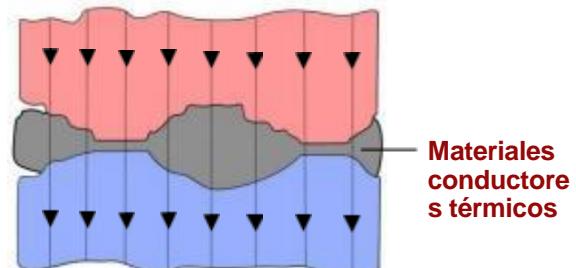
Resumen de Materiales de Interfaz Térmica

Teoría de la Conducción Térmica

El calor del elemento calefactor se puede descargar de manera efectiva y rápida, evitando que la temperatura del componente calefactor sea demasiado alta, lo que puede provocar una disminución en la eficiencia de trabajo o daños.



Antes de usar



Después del uso

Conductividad Térmica K

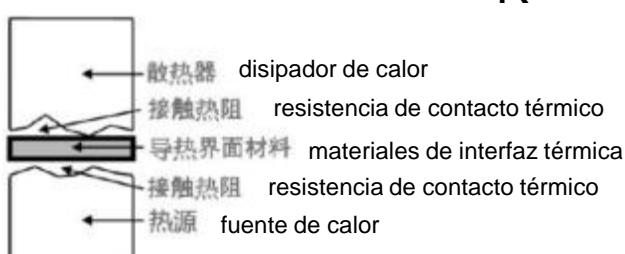
La relación entre el calor y el tiempo cuando la diferencia de temperatura es de 1 (K o °C) por unidad de área y unidad de espesor. La conductividad térmica es una magnitud física que describe la capacidad de transferencia de calor de un material. Es una propiedad inherente a los materiales homogéneos y no tiene relación con el tamaño ni la forma del material.

$$K = \frac{\text{d}Q}{A \cdot dt}$$

Resistencia Térmica R

La cantidad de resistencia a la transferencia de calor a través de una interfaz o un material, una propiedad que está relacionada con el espesor y el área.

Contacto R: resistencia de contacto térmico



$$R = \frac{X(\text{espesor})}{K}$$

R_{contact}

Todos los componentes que necesitan disipar calor pueden utilizar materiales de interfaz térmica.



Nuevas Estaciones de Energía y Carga



Servidor



Estación base de comunicaciones



Ordenador portátil



Pantalla de TV



Terminal móvil



Productos Médicos



Panel Solar



LED

Lista de Productos

Resumen de Materiales de Interfaz Térmica

SC-TP

Almohadilla de Aislamiento Térmico

SC-TCF

Almohadilla Conductora Térmica de Fibra de Carbono

SC-TFC

Material de Cambio de Fase conductor Térmico

SC-TS

Barro de Aislamiento Térmico

SC-TG

Pasta Térmica

SC-TIS

Grasa de Aislamiento Térmico

SC-TA

Material Absorbente de Ondas Conductoras Térmicas

SC-NTP

Almohadilla Térmica de PMMA con Aceite sin Silicona

SC-CH

Disipador de Calor Cerámico Térmico

SC-STG/DTG

Gel Conductor Térmico

Troquelado de Precisión

Grafito, espuma conductora, aerogel de aislamiento térmico, cinta de doble cara, etc.

SC-TP

Almohadilla de Aislamiento Térmico

Introducción

La silicona térmicamente conductora tiene alta suavidad, buena compresibilidad, fuerte autoadhesividad y excelente rendimiento de relleno.

Propiedad

Conductividad térmica de 1,5-15,0 W/m-k, se puede dispersar en superficies irregulares, sin deformación, fuerte autoadhesión, baja impedancia térmica, ignífugo y buen aislamiento.



Solicitud

- Dispositivo de refrigeración para baterías de litio de automóviles
- Equipos de iluminación LED
- Equipos de conversión de energía
- Equipos de conversión de la fuente de alimentación
- Unidad de control del motor de automóviles
- Aplicación de amortiguación de vibraciones

Nombre del producto	SC-TP150	SC-TP200	SC-TP300	SC-TP400	SC-TP500	SC-TP600	SC-TP800	SC-TP1000	SC-TP1200	SC-TP1500
Color	Azul Claro	Blanco	Verde claro	Púrpura	Amarillo	Rosa	Gris Claro	Gris Claro	Gris Claro	Gris Claro
Conductividad Térmica W/m-K	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	15.0
Espesor mm	0.15 ~ 10	0.2 ~ 10	0.25 ~ 10	0.3 ~ 10	0.5 ~ 10	0.5 ~ 10	0.5 ~ 10	0.5 ~ 10	0.5 ~ 10	0.5 ~ 10
Dureza	40	40	45	45	50	50	55	55	55	55
Densidad g/cm ³	1.75	2.5	2.98	3.1	3.2	3.26	3.36	3.3	3.3	3.3
Tensión de Rupture KV (>1mm)	>6	>6	>5	>5	>5	>5	>6	>5	>5	>5
Constante Dieléctrica@1 Mhz	5.3	7.0	7.3	7.5	7.4	7.9	7.2	7.0	7.0	7.0
Resistividad de Volumen Ω·cm	10 ¹²	10 ¹³	10 ¹³	10 ¹³	10 ¹⁰	10 ¹²				
Rango de Temperatura °C	40~150	-40~150	-40~150	-40~150	-40~150	-40~150	-40~150	-40~150	-40~150	-40~150
Clasificación de Llama	94V-0									

El contenido y la información técnica anteriores se basan en los resultados experimentales de nuestra empresa, pero no constituyen una interpretación legal ni una garantía. Antes de su uso, los usuarios deben evaluar el propósito y el alcance del producto.

SC-TCF

Almohadilla Conductora Térmica de Fibra de Carbono

Introducción

SC-TCF es una nueva almohadilla térmica direccional ligera y de alta resistencia con una conductividad térmica ultraalta y una resistencia térmica ultrabaja. Mediante una tecnología avanzada de disposición, el material de relleno termoconductor se distribuye uniforme y verticalmente en la matriz de moléculas de alta conductividad térmica, lo que mejora considerablemente la eficiencia de transferencia de calor. Al mismo tiempo, su baja relación de relleno le confiere buenas propiedades mecánicas y una excelente estabilidad térmica, siendo ampliamente utilizado en el sector electrónico con altos requisitos de disipación de calor. Este relleno de alta conductividad térmica es fibroso y puede diseñarse con orientación térmica, lo que constituye la principal diferencia y ventaja respecto a los materiales termoconductores anteriores.

Propiedad

- Conductividad térmica: 20-35 W/m·K
- Impedancia térmica ultrabaja, baja tasa de llenado, peso ligero
- Cero filtraciones de aceite, excelente fiabilidad
- Seguro y respetuoso con el medio ambiente, compatible con RoHS
- Resistente a la corrosión y antioxidante



Solicitud

Aplicación del producto:

- Satélites, radares
- Grandes servidores
- Centros de procesamiento de datos
- Convertidores de señales
- Dispositivos de almacenamiento masivo
- Dispositivos de alta potencia
- Equipos de comunicación electrónica

Nombre del producto	SC-TCF2000	SC-TCF2500	SC-TCF3000	SC-TCF3500
Color	Negro	Negro	Negro	Negro
Dimensiones Estándar (mm)	100*100	100*100	100*100	100*100
Espesor mm	0.5 to 5.0	0.5 to 5.0	0.5 to 5.0	0.5 to 5.0
Conductividad Térmica W/m·K	20.00	25.00	30.00	35.00
Dureza (Shore00)	55±5	55±5	55±5	55±5
Densidad g/cm³	2.5±0.2	2.5±0.2	2.5±0.2	2.5±0.2
Tensión de Rupture KV (>1mm)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Clasificación de Llama	V-0	V-0	V-0	V-0
Rango de Temperatura °C	-40 to 150	-40 to 150	-40 to 150	-40 to 150
Resistencia Térmica @50psi@1mm(°C·cm²/W)	≤0.11	≤0.11	≤0.11	≤0.11

El contenido y la información técnica anteriores se basan en los resultados experimentales de nuestra empresa, pero no constituyen una interpretación legal ni una garantía. Antes de su uso, los usuarios deben evaluar el propósito y el alcance del producto.

SC-TFC

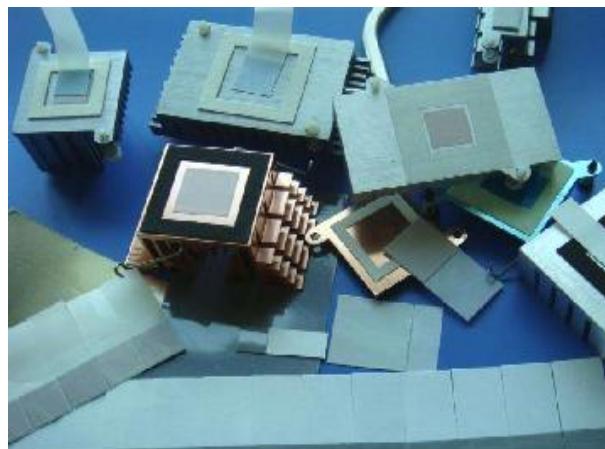
Material de Cambio de Fase Conductor Térmico

Introducción

Los materiales de cambio de fase termoconductores se utilizan a menudo para llenar los huecos entre procesadores de alta eficiencia y módulos de disipación de calor, proporcionando una resistencia térmica extremadamente baja. Este material experimenta un cambio de fase a 50-52 °C, presenta cierta fluidez, pero no se desborda, puede llenar completamente los huecos, humedecer completamente la superficie de contacto y mejorar la capacidad de transferencia de calor entre la parte calefactora y la parte disipadora. Las almohadillas termoconductoras poseen propiedades adhesivas inherentes, no requieren una capa adhesiva y cubren las irregularidades microscópicas de la superficie, permitiendo que las piezas acopladas estén en pleno contacto y mejorando la eficiencia de la transferencia de calor.

Propiedad

- Resistencia térmica muy baja
- Superficie altamente adhesiva para un uso sencillo
- Cumple con RoHS



Solicitud

- Computadoras de escritorio, portátiles y servidores
- Microprocesadores
- Chips y chipsets
- Módulos de refrigeración para portátiles
- Tarjetas gráficas
- Módulos de almacenamiento

Color	Rosa	Amarillo	Gris	Gris	Gris	Gris
Conductividad Térmica W/m·K	1.0±0.3	2.0±0.3	3.0±0.3	5.0±0.3	6.0±0.3	8.0±0.3
Espesor mm	0.1 ~ 1.0	0.1 ~ 1.0	0.1 ~ 1.0	0.1 ~ 0.5	0.1 ~ 0.5	0.1 ~ 0.5
Cambio de Temperatura °C	55 ~ 60	55 ~ 60	45 ~ 55	45 ~ 55	45 ~ 55	45
Densidad g/cm	2.3	2.7	3.15	2.8	2.8	2.8
Impedancia Térmica 50psi(°C·cm ² /W)	<0.22	<0.18	<0.14	< 0.07	< 0.06	< 0.05
Coeficiente dieléctrico MHz	3n1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
Resistividad de Volumen Ω·cm	4.0x 10¹³	4.0x 10¹³	4.0x 10¹³	2.0x 10¹³	2.0x 10¹³	2.0x 10¹³
Rango de Temperatura °C	-20~120	-20~120	-20~120	-20~120	-20~120	-20~150

El contenido y la información técnica anteriores se basan en los resultados experimentales de nuestra empresa, pero no constituyen una interpretación legal ni una garantía. Antes de su uso, los usuarios deben evaluar el propósito y el alcance del producto.

SC-TS

Barro de Aislamiento Térmico

Introducción

Como medio de transferencia de calor, el lodo termoconductor FG presenta una excelente conductividad térmica, buena lubricidad y aislamiento eléctrico, así como una buena resistencia a altas y bajas temperaturas. Presenta baja viscosidad y un buen rendimiento de construcción. Este producto está basado en polisiloxano y complementado con cargas de alta conductividad térmica. Es atóxico, inodoro y no corrosivo. Cumple con las directivas R O H S y los requisitos de protección ambiental relacionados, y presenta propiedades químicas y físicas estables.

Propiedad

- Gran plasticidad, fácil de usar
- Humedezca bien la superficie de contacto para mejorar la disipación del calor
- Seguro y respetuoso con el medio ambiente, cumple con la normativa RoHS



Solicitud

- Procesadores de computadora (CPU)
- Chips y chipsets fuentes de alimentación y SAI
- Tarjetas gráficas, pantallas planas LCD y PDP
- Dispositivos de almacenamiento masivo
- Ventiladores de refrigeración de computadora

Configuración y Almacenamiento del Producto

1 kg/lata, 2 kg/lata, 10 kg/bidón; jeringa de 30 cc.
Conservar en un lugar fresco y seco. Caducidad: 12 meses

Color	Blanquecino	Blanquecino	Blanquecino
Conductividad Térmica W/m·K	1.0±0.3	2.0±0.3	3.0±0.3
Densidad g/cm	1.75	2.3	2.98
Tensión de Ruptura KV (>1mm)	4	4	4
Resistividad de Volumen Ω·cm	4.0x 10¹³	4.0x 10¹³	4.0x 10¹³
Rango de Temperatura °C	-40~150	-40~150	-40~150
Clasificación de Llama	94V-0	94V-0	94V-0
Embalaje	Relleno	Relleno	Relleno

El contenido y la información técnica anteriores se basan en los resultados experimentales de nuestra empresa, pero no constituyen una interpretación legal ni una garantía. Antes de su uso, los usuarios deben evaluar el propósito y el alcance del producto.

SC-TG

Pasta Térmica

Introducción

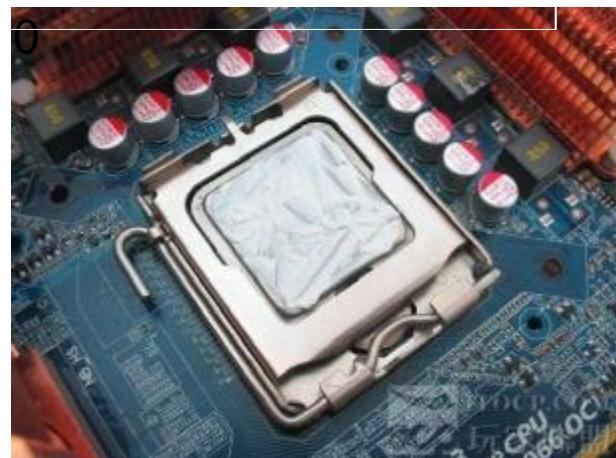
Como medio de transferencia de calor, la pasta térmica TG presenta una excelente conductividad térmica, buena lubricidad y aislamiento eléctrico, además de buena resistencia a altas y bajas temperaturas; presenta baja viscosidad y un buen rendimiento de construcción. Este producto está basado en polisiloxano y complementado con cargas de alta conductividad térmica. Es atóxico, inodoro y no corrosivo, cumple con la directiva ROHS y los requisitos de protección ambiental relacionados, y presenta propiedades químicas y físicas estables.

Propiedad

- Conductividad térmica: 1,0-6,0 W/m·k
- Resistencia térmica extremadamente baja, mejor transferencia de calor
- Humedeza completamente la superficie de contacto para mejorar la disipación del calor
- Seguro y ecológico, cumple con la normativa RoHS

Solicitud

- Procesadores de computadora (CPU)
- Chips y chipsets
- Fuentes de alimentación y SAI (sistemas de alimentación ininterrumpida)
- Tarjetas gráficas
- Pantallas planas LCD y PDP
- Dispositivos de almacenamiento masivo
- Ventiladores de computadora



Configuración y Almacenamiento del Producto

1 kg/lata, 2 kg/lata, 10 kg/bidón; jeringa de 30 cc.

Conservar en un lugar fresco y seco. Caducidad: 12 meses

Color	Blanco	Blanquecino	Gris	Gris	Gris	Gris
Conductividad Térmica W/m·K	1.0±0.3	2.0±0.3	3.0±0.3	4.0±0.3	5.0±0.3	6.0±0.3
Evaporación	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Densidad g/cm	2.2	2.5	2.78	3.15	3.15	3.15
Impedancia Térmica 50psi(°C·cm ² /W)	0.256	0.212	0.221	0.256	0.08	0.08
Tensión de Rupture KV (>1mm)	5	5	5	5	5	5
Rango de temperatura °C	-40~150	-40~150	-40~150	-40~150	-40~150	-40~150

El contenido y la información técnica anteriores se basan en los resultados experimentales de nuestra empresa, pero no constituyen una interpretación legal ni una garantía. Antes de su uso, los usuarios deben evaluar el propósito y el alcance del producto.

SC-TIS

Grasa de Aislamiento Térmico

Introducción

TIS es un compuesto de encapsulado de silicona ignífugo, de dos componentes, de alta conductividad térmica, curable a temperatura ambiente y con un largo tiempo de trabajo. Es especialmente adecuado para encapsular condensadores y pequeños dispositivos electrónicos. Su flexibilidad y elasticidad le permiten proporcionar una capa protectora para el material recubierto. Su baja viscosidad permite que el compuesto de encapsulado, conductor térmico, cubra la superficie de forma más completa durante el proceso, mejorando considerablemente la eficiencia de la conducción térmica desde el dispositivo de calentamiento o la PCB completa hasta la carcasa metálica o la placa de difusión, aumentando así la eficiencia y la vida útil de los componentes electrónicos.

Propiedad

- Buen aislamiento
- Baja viscosidad, lo que favorece la descarga de gases
- Buena resistencia a los disolventes y al agua
- Excelente resistencia a altas y bajas temperaturas

Solicitud

- Fuente de alimentación, conector, sensor, control industrial, transformador, bobina, amplificador, paquete de alta tensión, relé, caja de conexiones de alta corriente, etc.
- Montaje de dissipador de calor, encapsulado de sensor térmico, encapsulado de productos conductores térmicos
- Conducción de calor entre la celda de la batería y el tubo de refrigeración
- Encapsulado de LED y controlador de potencia

Nombre del producto	SC-TIS15AB	SC-TIS20AB	SC-TIS30AB	SC-TIS40AB
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Conductividad Térmica W/m·K	1.2	2.0	3.0	4.0
Espesor mm	0.15 ~ 5	0.2 ~ 5	0.25 ~ 5	0.3 ~ 5
Dureza Shore A	40	40	50	50
Densidad g/cm ³	1.75	2.5	2.98	3.1
Tensión de Ruptura KV (>1mm)	>6	>6	>5	>5
Constante Dieléctrica @1Mhz	5.3	7.0	7.3	7.5
Resistividad de Volumen Ω·cm	10 ¹²	10 ¹³	10 ¹³	10 ¹³
Rango de Temperatura °C	-40~150	-40~150	-40~150	-40~150
Clasificación de Llama	94V-0	94V-0	94V-0	94V-0

El contenido y la información técnica anteriores se basan en los resultados experimentales de nuestra empresa, pero no constituyen una interpretación legal ni una garantía. Antes de su uso, los usuarios deben evaluar el propósito y el alcance del producto.

SC-TA

Material Absorbente de Ondas Conductoras Térmicas

Introducción

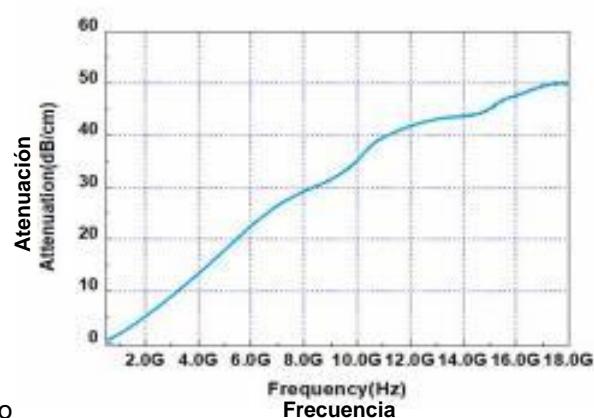
Los parches absorbentes termoconductores SC-TAxxx presentan buena conductividad térmica, absorben ondas electromagnéticas, tienen efecto de apantallamiento y soportan la tensión de aislamiento. Su baja resistencia térmica en la interfaz se logra a presiones relativamente bajas. Su eficaz eliminación del aire permite un buen efecto de relleno. Se pueden aplicar directamente entre el disipador de calor y la carcasa metálica para una eficiente transferencia de energía térmica. Además, ofrecen apantallamiento electromagnético y absorción de interferencias electromagnéticas, lo que proporciona una solución eficaz para productos electrónicos en cuanto a conductividad térmica y apantallamiento electromagnético.

Propiedad

- Alta conductividad térmica, baja resistencia térmica
- Buen aislamiento y resistencia a la tensión
- Excelente capacidad de atenuación de ondas electromagnéticas, buena compatibilidad con superficies
- Buena resiliencia, buena autoadhesividad
- Alta fiabilidad a largo plazo

Solicitud

- Estaciones base 5G
- Vehículos aéreos no tripulados/drones
- Módulos ópticos, amplificadores
- Portátiles, routers, televisores
- Equipos médicos, instrumentos de diagnóstico electrónico



Características	SC-TA300	Unidad	Método de prueba
Color	Gris Oscuro	-	Visual
Espesor	0.5-3.0	mm	ASTM D374
Dureza	50	Shore 00	ASTM D2240
Densidad	3.1	g/cm³	ASTM D792
Rango de Temperatura	-45~150	°C	N/A
Tasa de atenuación	30	dB/cm	@8Ghz
	45	dB/cm	@15Ghz
Tensión de Rupture	>6	KV	ASTM D149
Resistencia superficial	10 ¹⁰	Ω	ASTM D2574
Conductividad Térmica	3.0	W/mk	ASTM C518-98

El contenido y la información técnica anteriores se basan en los resultados experimentales de nuestra empresa, pero no constituyen una interpretación legal ni una garantía. Antes de su uso, los usuarios deben evaluar el propósito y el alcance del producto.

SC-NTP

Almohadilla Térmica de PMMA con Aceite sin Silicona

Introducción

Las almohadillas térmicas NTP sin silicona son materiales acrílicos con excelentes propiedades de autoadhesividad, ausencia de fugas de aceite y resistencia a la corrosión. A diferencia de las almohadillas térmicas convencionales, las almohadillas sin silicona ofrecen una excelente resistencia mecánica, tenacidad y resistencia al desgaste. Son aptas para entornos especiales, como baterías de litio de alto voltaje y alto impacto. En baterías de litio, las almohadillas sin silicona previenen eficazmente la disolución de los electrolitos, por lo que se utilizan ampliamente en la industria de las baterías de litio.

Propiedad

- Sin manchas de aceite, evita la contaminación por aceite.
- Propiedades únicas del ácido acrílico: fuerte adhesión, sin necesidad de adhesivo.
- Seguro y respetuoso con el medio ambiente, cumple con RoHS.



Solicitud

- Procesadores de computadora (CPU)
- Chips y chipsets
- Fuentes de alimentación y SAI (sistemas de alimentación ininterrumpida)
- Tarjetas gráficas
- Pantallas planas LCD y PDP
- Dispositivos de almacenamiento masivo
- Ventiladores de computadora

Nombre del producto	SC-NTP150	SC-NTP200	SC-NTP300	SC-NTP400	SC-NTP500	SC-NTP600
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Conductividad Térmica W/m·K	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
Espesor mm	0.15 ~ 5	0.2 ~ 5	0.25 ~ 5	0.3 ~ 5	0.5 ~ 5	0.5 ~ 5
Dureza Shore00	65	65	65	65	65	65
Densidad g/cm ³	1.75	2.5	2.98	3.1	3.2	3.26
Tensión de Rupture KV (>1mm)	>6	>6	>5	>5	>5	>5
Constante Dieléctrica @1Mhz	5.3	7.0	7.3	7.5	7.4	7.9
Resistividad de Volumen Ω·cm	10 ¹²	10 ¹³	10 ¹³	10 ¹³	10 ¹⁰	10 ¹²
Rango de Temperatura °C	-40~150	-40~150	-40~150	-40~150	-40~150	-40~1
Grado Retardante de Llama	94V-0	94V-0	94V-0	94V-0	94V-0	94V-0

El contenido y la información técnica anteriores se basan en los resultados experimentales de nuestra empresa, pero no constituyen una interpretación legal ni una garantía. Antes de su uso, los usuarios deben evaluar el propósito y el alcance del producto.

SC-CH

Disipador de Calor Cerámico Térmico

Introducción

El material cerámico H.SAC se caracteriza por su buen aislamiento, alta conductividad térmica, alta tasa de radiación infrarroja y bajo coeficiente de expansión. Se ha convertido en un nuevo material para la disipación de calor en productos de iluminación LED y comunicación en red.

El H.SAC soporta altas corrientes, alta tensión, fugas, es silencioso y no produce capacitancia parásita de acoplamiento con MOS y otros tubos de potencia, simplificando así el proceso de filtrado. La distancia de fuga requerida es menor que la exigida por el organismo financiero, lo que ahorra espacio en la placa y facilita el diseño y la certificación eléctrica de los ingenieros. El H.SAC tiene disipación de calor multidireccional y es adecuado para el encapsulado de circuitos integrados (CI) con disipación de calor multidireccional.

El material H.SAC es compacto, ligero, ocupa poco espacio y facilita un diseño de producto razonable.

El H.SAC tiene un buen rendimiento de disipación y transferencia de calor, lo que puede resolver eficazmente el problema de disipación de calor de productos electrónicos y componentes de potencia, prolongando su vida útil.

Propiedad

Como material ecológico y respetuoso con el medio ambiente, este producto se utiliza principalmente en la iluminación LED y en las industrias electrónicas afines. Los productos cerámicos H.SAC pueden resolver eficazmente los problemas de conductividad térmica y disipación de calor en las industrias electrónica y optoelectrónica, además de brindar soporte técnico y avances para la innovación y el desarrollo de productos electrónicos.

Solicitud

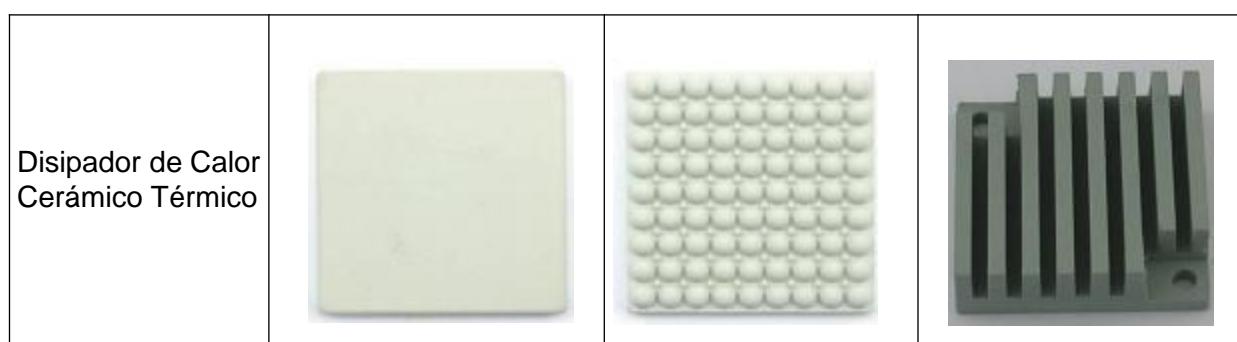
- Componentes: Circuitos integrados, chipsets, CPU, MOS, SouthBridge
- LED: Disipador de calor para iluminación general (comercial)
- TV: TV LCD delgada/decodificador
- Equipo de red: Punto de acceso, Router, ADSL, Moderno, Software
- Tecnología de la información: M/B, NB, Vídeo, Tarjeta
- Memoria: DDR3-DIMM, SO-DIMM, SSD
- Fuente de alimentación: Módulo de potencia, Transistor de potencia

Tamaño

Tamaño del producto: Varias formas

SC-CH

Disipador de Calor Cerámico Térmico



El contenido y la información técnica anteriores se basan en los resultados experimentales de nuestra empresa, pero no constituyen una interpretación legal ni una garantía. Antes de su uso, los usuarios deben evaluar el propósito y el alcance del producto.

SC-CH

Disipador de Calor Cerámico Térmico

Artículos de Especificaciones	Unidad	Datos	Prueba
Propiedades Físicas	Densidad S.G.	g/cm ³	2.0 ±0.05 GB/T 3810.3-2006
	Porosidad	%	30 GB/T 3810.3-2006
Propiedades Mecánicas	Mohs Dureza	Mohs	5~6 DIN EN101-1992
	Resistencia a la Flexión	MPa	87.82 GB/T 14389-14390
	Conductividad Térmica	w/m-k	>9 HOT DISK
	Temperatura máxima de funcionamiento	°C	< 700
Composición Química	SiC	Pureza	>99%
Varias certificaciones	Rigidez dieléctrica (DC)	Voltaje	6.96kV/mm IEC 60243-2:2001 SGS
	Rigidez dieléctrica (AC)	Voltaje	4.87kV/mm ASTM D149-09 Método A / SGS
	RoHS		Aprobado (Informe N°: GC130301375-GZ) SGS
	Prueba de Caída		Aprobado (Informe N°: GZRL2012081591) Caer alto 700mm en 30×30mm PCB / SGS

El contenido y la información técnica anteriores se basan en los resultados experimentales de nuestra empresa, pero no constituyen una interpretación legal ni una garantía. Antes de su uso, los usuarios deben evaluar el propósito y el alcance del producto.

SC-STG/DTG

Gel Conducto Térmico

Introducción

- El gel termoconductor de la serie SC-STG/DTG es un material termoconductor pastoso que rellena huecos. Se adapta a la forma de la estructura; para superficies irregulares de cerámica, radiadores o cavidades, ofrece la mejor aplicabilidad estructural y adaptabilidad superficial a las piezas estructurales, llenando completamente los huecos.
- El gel termoconductor de la serie SC-STG/DTG ofrece buen aislamiento, resistencia a la tensión y estabilidad térmica, además de ser seguro y fiable.
- El gel termoconductor de la serie SC-STG/DTG puede fluir bajo presión como la grasa de silicona; presenta una alta fiabilidad bajo la acción del ciclo térmico y no se solidifica.

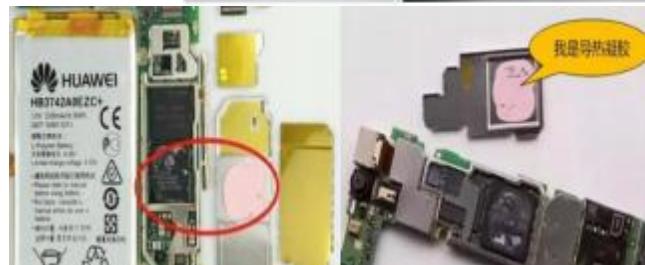
Propiedad

- Uso de un solo componente
- Sin curado, alta fiabilidad
- Buena aplicación en huecos de estructura irregular
- Buen aislamiento eléctrico, satisfaciendo las necesidades de dispositivos electrónicos
- Buenas propiedades mecánicas y resistencia a la intemperie



Solicitud

- Equipos de comunicación
- Equipos de almacenamiento
- Teléfonos móviles, relojes inteligentes
- Equipos de seguridad
- Terminal de red
- Lámparas LED
- Dispositivo de alimentación



Rendimiento del Gel Termoconductor Monocomponente (SC-STG)

Nombre del Producto	SC-STG400	SC-STG600	SC-STG800
Color	Bermellón	Amarillo	Amarillo
Conductividad Térmica (W/m ·K)	4.0 ± 0.3	6.0 ± 0.3	8.0 ± 0.3
Densidad (g/cm ³)	3.0	3.2	3.3
Volumen de Extrusión (g/min) 2.54mm cabeza de jeringa, 90psi presión (30cc envase)	30 ± 5	20 ± 5	20 ± 5
Tensión de Rupture (kV/mm)	>5	>5	>5
Resistividad de Volumen (Ω ·cm)	9.5×10^{13}	4×10^{13}	4×10^{13}
Temperatura de Funcionamiento (F/°C)	-40~150	-40~150	-40~150
Método de Envío	Volumen del embalaje (o enlatado) de la jeringa: 30cc /pc, 300cc /pc, 2600cc /pc		
Duración (@25±5°C, 70%RH)	6 meses		

El contenido y la información técnica anteriores se basan en los resultados experimentales de nuestra empresa, pero no constituyen una interpretación legal ni una garantía. Antes de su uso, los usuarios deben evaluar el propósito y el alcance del producto.

SC-DTG

Gel Conductor Térmico

Rendimiento del Gel Termoconductor Térmico de Dos Componentes (SC-DTG)

	SC-DTG180		SC-DTG350	
Rendimiento de Premezcla	Grupo A	Grupo B	Grupo A	Grupo B
Color	Blanco	Amarillo	Blanco	Amarillo
Viscosidad (mPa· s)	250×10^3	250×10^3	200×10^3	200×10^3
Densidad (g/cm³)	2.65	2.65	2.75	2.75
Proporción de Mezcla	1:1		1:1	
Rendimiento Posterior a la Mezcla				
Color	Amarillo		Amarillo	
Dureza (Shore OO)	60(1:1 after curing)		60(1:1 after curing)	
Conductividad Térmica (W/mK)	1.8		3.5	
Tensión de Ruptura (KV/mm)	>5		>5	
Grado retardante de Llama	UL94 V-0		UL94 V-0	
Temperatura de Funcionamiento (°C)	-40-150		-40-150	
Tiempo de Curado Completo				
25°C (H)	5		15	
100°C (min)	15		40	

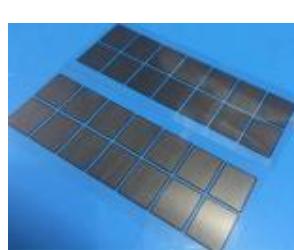
El contenido y la información técnica anteriores se basan en los resultados experimentales de nuestra empresa, pero no constituyen una interpretación legal ni una garantía. Antes de su uso, los usuarios deben evaluar el propósito y el alcance del producto.

Troquelado de Precisión

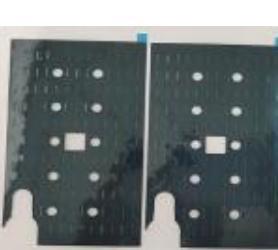


Línea profesional de troquelado combinado de orificios pequeños, productos que satisfacen múltiples requisitos de perforación

Máquina de pruebas CNC, sin necesidad de fabricar moldes, lo que ahorra costos de moldes para los clientes



Troquelado de doble filo de grafito



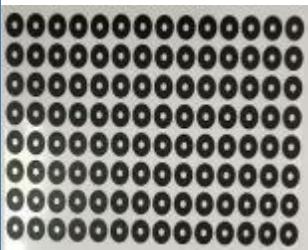
Troquelado de espuma de grafito



Troquelado de láminas de cobre y aluminio



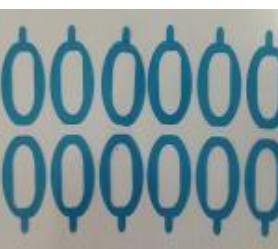
Troquelado de almohadilla térmica



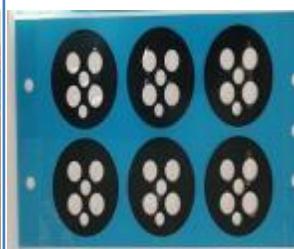
Troquelado de juntas de PC



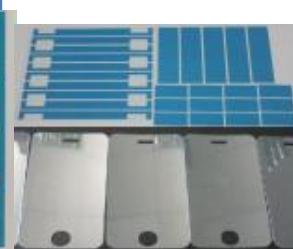
Troquelado de material aislante



Troquelado adhesivo de doble cara



Troquelado adhesivo para respaldo de cámara



Troquelado de película protectora



espuma conductora

El contenido y la información técnica anteriores se basan en los resultados experimentales de nuestra empresa, pero no constituyen una interpretación legal ni una garantía. Antes de su uso, los usuarios deben evaluar el propósito y el alcance del producto.



Su Éxito es Nuestra Búsqueda

GRACIAS



SPEED SPREAD
Electronic Materials Co., Ltd.